

Nouvelle protection sur chipset d2e avec une colle époxy

Soumis par robocop
21-09-2008

Les poseurs de puce Wii vont être contents dans leur guerre contre les WIICLIPS. Nintendo commence à diffuser des consoles avec de la résine noire (EPOXY) sur le chipset et la carte mère ce qui devrait gêner la pose de WIICLIP. Mais heureusement la pose de puce traditionnelle ne craint rien et pour deux raisons : la première est que les points de soudure alternatifs sont toujours là et que cette résine peut s'enlever.

Selon la qualité du travail de nettoyage de cette résine, le WIICLIP risque de ne pas tenir. Dans ces cas là la pose de puce sera nécessaire.

Les méthodes pour enlever la résine sont:

- Utiliser un canon à air chaud et chauffer à 80-90°C (équivalent du sèche cheveux en plus puissant)
- Utiliser une solution chimique
- Utiliser un outil Dremel pour effectuer un montage de type "9fils".

En bref il ne s'agit que d'un frein mais pas suffisamment efficace pour tout stopper.